



Deep Access Wedge- Wedge Bonder 5632i

Bond System

| | |
|---------------------------|---|
| Drahttypen | Alu- und Golddrähte 12,5 - 75 µm auf 2"-Spule Bändchen von 30 x 12,5 µm bis 250 x 25 µm |
| Bondkopf | Deep Access Wedge für Dünndraht oder Bändchen Standard Tool von 1" Länge (optional ¾") Motorisierte Drahtabspulung (optional) |
| Ultraschall System | F&S US System 100 kHz (optional 65, 120, 140 kHz) |

Maschinen Basis

Achsen

- Arbeitsbereich X/Y-Achse 100 x 100 mm
- Schrittauflösung 1 µm programmierbar
- Programmierbare Z-Achse mit 60 mm Hub

Hardware

- Dual-Core PC mit Windows OS Ethernet
- USB 2.0/3.0, LCD Farbdisplay 22"
- GigE-CMOS-Farbkamera
- Netzwerkfähig mit Programm-Archivierung

Software

- Einzelbonds bis komplexe Programme
- Loopformen in Bibliotheken speicherbar
- Optionale Bildererkennung

Geschwindigkeit

- 1 Draht / 2 - 3 Sekunden

Abmessung

B x T x H – 70 x 65 x 70 cm, Gewicht ca. 75 kg

Anschlüsse

100-240 VAC, 1 Phase, 50/60 Hz, max 500 VA
Ø 6mm Standard-Vakuumschlauch

Heizung

Steuerung in der Maschine integriert 0-250 °C

Die 56xx Serie:

Der semiautomatische Deep-Access Wedge Bonder 5632i ist auf Basis der 56xx-Serie voll PC-gesteuert und es sind beliebig viele Bonds oder Bumps programmierbar.

Die programmierten Zielpunkte werden über das Kamerazielfadenkreuz angefahren und die programmierten Bonds oder Bumps werden automatisch gebondet.

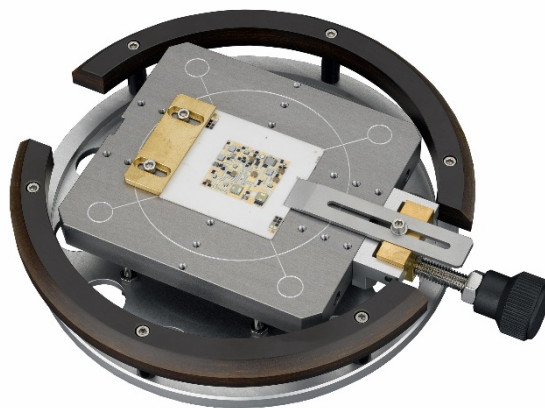
F&S BONDTEC bietet bei dieser Maschine zwei Modis an: Singlebond zum Reparieren von div. Bondsamples und zum Setzen von Einzelbonds (manuell -automatisch) und Multiwire zum Teachen und Bonden von Chips oder div. Bondsamples (semi- und vollautomatisch).

Durch einfachen Wechsel der Bondköpfe und der Software kann diese Maschine auch auf Dünndraht, Dickdraht Wedge-Wedge oder Heavy Ribbon Bonder umgerüstet werden. Ebenso ist die Maschine als Pull-/Sheartester einsetzbar.

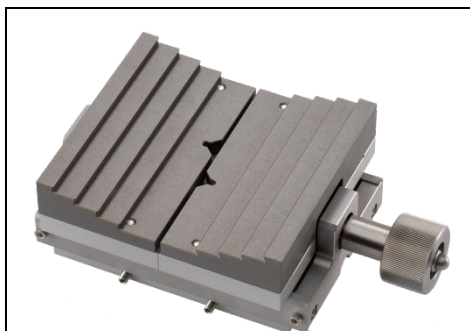
Werkzeugloses Umrusten in ca. 3 Minuten möglich.

Substrathalter

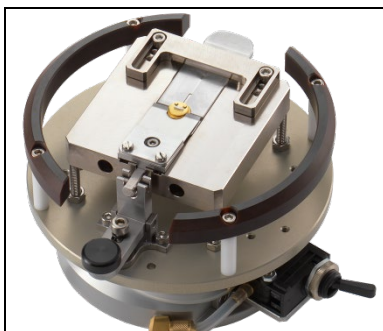
Standard-Substrataufnahme
für Bauteile bis 4x4" mit
Vakuum und mechanischer Klemmung



Optional:



Substrathalter 4x4"
mit Stufenbacken



TO Aufnahme mit
mechanischer Klemmung



4x4" Substrataufnahme m.
gummierter Oberfläche, mit
mechanischer Klemmung

F&S Bondtec Semiconductor GmbH

Industriezeile 49a

A-5280 Braunau am Inn

Tel.: +43-7722-67052-8270

Fax: +43-7722-67052-8272

Mail: info@fsbondtec.at

Web: www.fsbondtec.at

